

# Investor Relations 2023





## Disclaimer

본 자료는 주주 및 기관투자자들을 대상으로 실시되는 프리젠테이션에서의 정보제공을 목적으로 **에스티**(이하 “회사”)에 의해 작성되었으며 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다.

본 프리젠테이션에의 참석은 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며 제한 사항에 대한 위반은 관련 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 대한 위반에 해당될 수 있음을 유념해주시기 바랍니다.

본 자료에 포함된 “예측정보”는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’ ‘(E)’ 등과 같은 단어를 포함합니다. 예측정보는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래실적은 “예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있고, 회사는 이에 대한 업데이트 책임을 지지 않습니다.

본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임직원들은 어떠한 책임도 부담하지 않고 어떠한 경우에도 민·형사상의 분쟁 및 다툼에 있어 증거자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.

# Contents

## Investment Highlights

Chapter. 01 ————— 본원사업

Chapter. 02 ————— 신사업(그린수소)

Chapter. 03 ————— 계열사

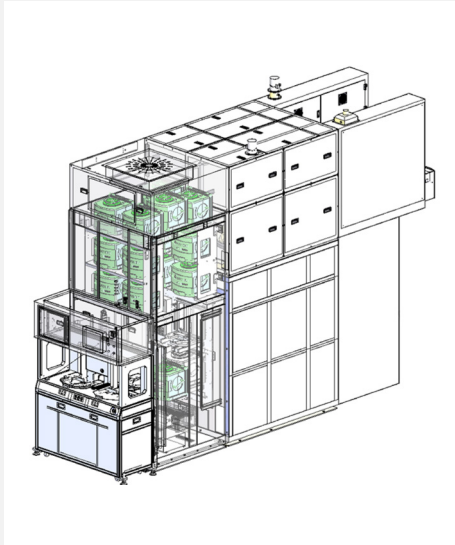
Chapter. 04 ————— Performance

Chapter. 05 ————— 일반개요

Chapter. 06 ————— Appendix

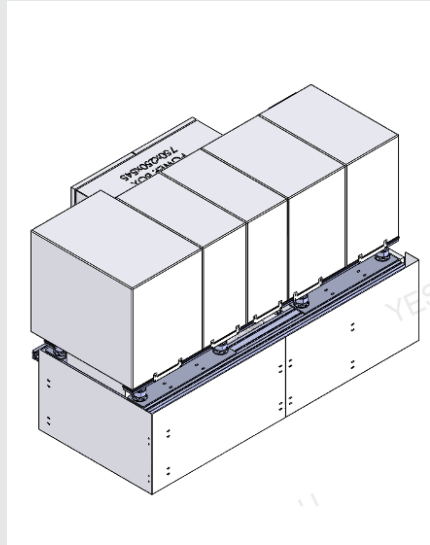
# Investment Highlights

## 반도체 중심 성장 가속화 I



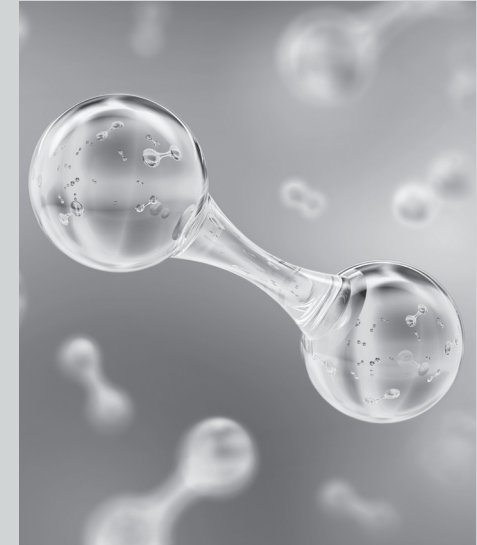
반도체 고압 어닐링 장비로  
고속 성장

## 반도체 중심 성장 가속화 II



질소 대체 네오콘,  
반도체 전 공정 적용 확대

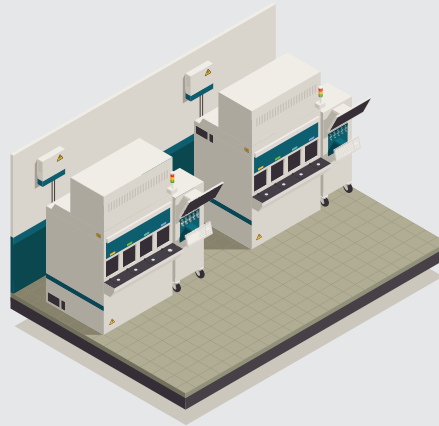
## 그린수소 시장 진출



자체 수소 생산기술 개발,  
기술력 내재화

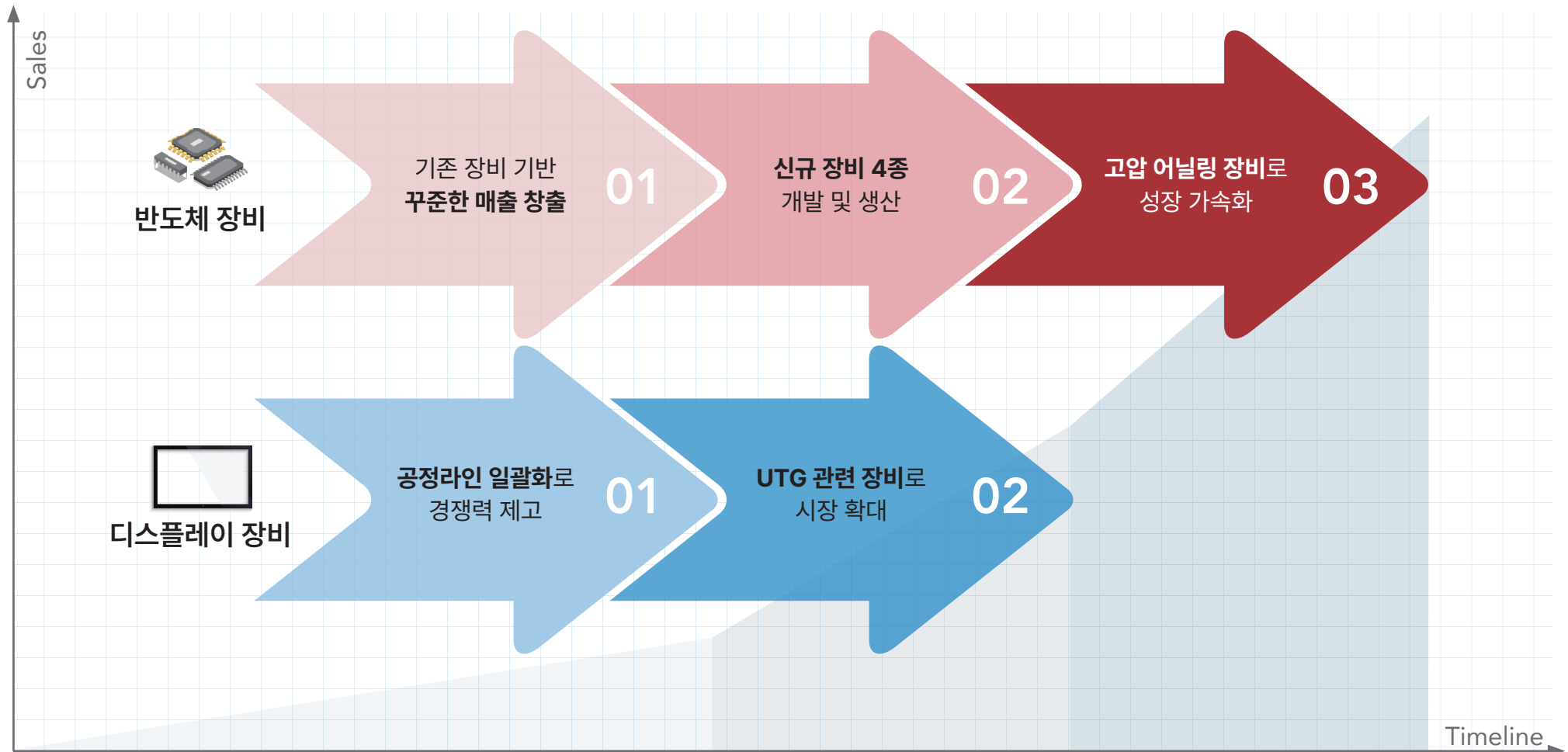
# Chapter. 01

## 본원사업



# 본원사업 Overview

반도체·디스플레이 장비 캐시카우 기반 지속성장 & 신규 장비로 성장 가속화



# 핵심역량

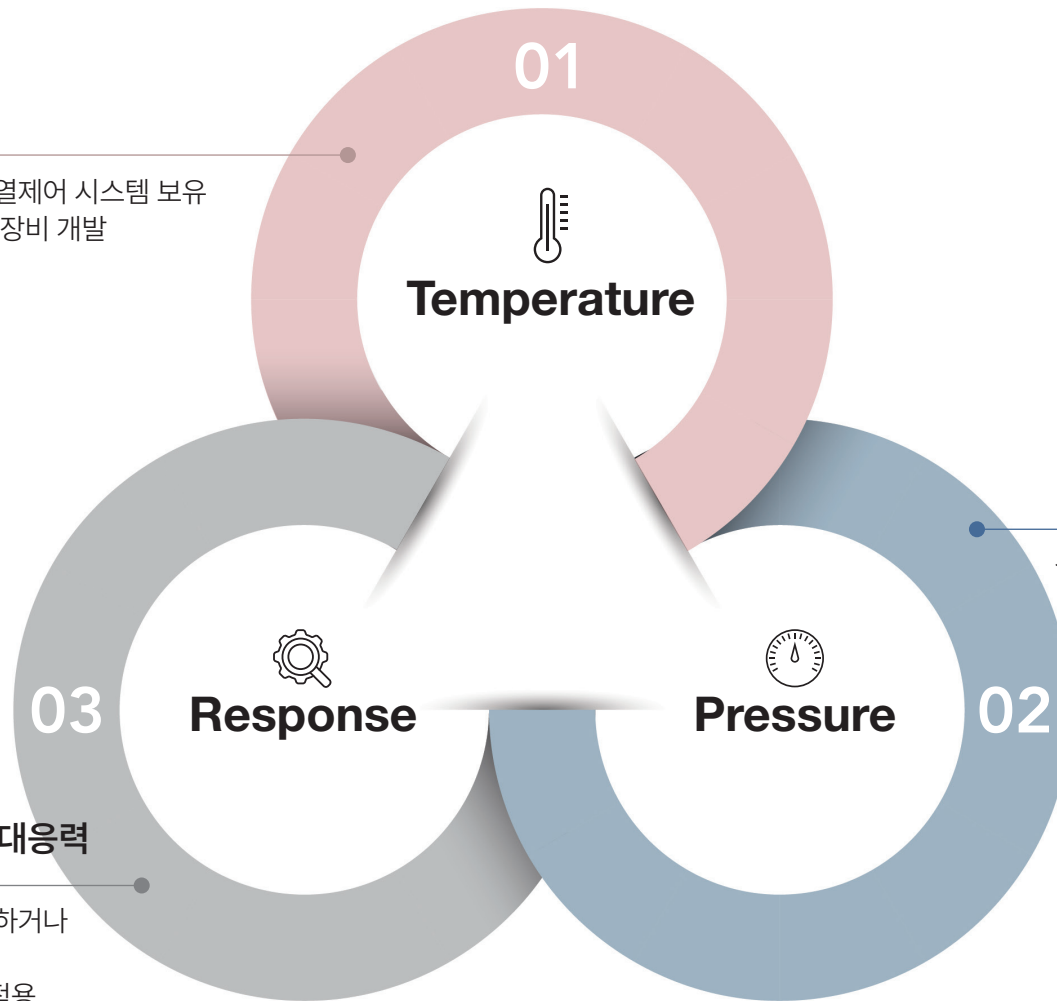
## 정밀온도·압력 제어기술 보유 & 가격경쟁력 높은 장비로 맞춤형 대응 가능

### 온도 제어 등 다양한 열원기술

고온과 저온 동시에 구현하는 독보적인 열제어 시스템 보유  
반도체 퍼니스 장비, 디스플레이 열처리 장비 개발

### 고객사의 요구조건에 맞는 빠른 대응력

장비 내 온도를 제어하면서 압력을 조절하거나  
진공상태 구현  
반도체·디스플레이 오토클레이브 장비 적용



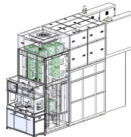
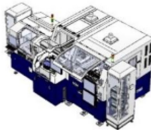
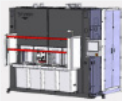
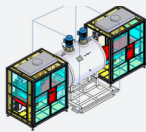
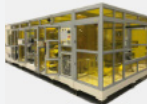
### 가압·감압을 비롯한 압력 제어 기술

설계 및 제작 능력 보유, 고객 니즈에 부합하는  
경쟁력·효율성 높은 장비 개발

# 캐시카우 성장 지속

## 에스티 보유 반도체·디스플레이 장비 포트폴리오

고객 니즈에 맞는 다양한 반도체 · 디스플레이 장비군 보유

| 기존·신규 장비<br>글로벌 기업<br>지속 공급 | 반도체 장비                                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                   | 디스플레이 장비                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                        | 개발 중                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | Furnace                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                       | NEOCON                                                                                            | Autoclave                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                        | <div><p>High Pressure<br/>D2 Anneal Furnace</p><p>PKG ITEM</p><p>Smart Storage</p></div> |
|                             |  <p>e-Furnace</p>                       |  <p>Diffusion</p>     |  <p>Vaccum</p>  |  <p>P-Furnace</p>   |  <p>NEOCON</p> |  <p>TV Panel</p>    |  <p>Mobile</p>           |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                             | Chiller                                                                                                                  |                                                                                                        | Autoclave                                                                                        |                                                                                                       | PCO                                                                                               | Lamination                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                             |  <p>Single &amp; Dual<br/>Chiller</p> |  <p>Cryochiller</p> |  <p>Wafer</p> |  <p>Autoclave</p> |  <p>PCO</p>  |  <p>Main Lami</p> |  <p>Film Auto Lami</p> |  <p>Slit Lami</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

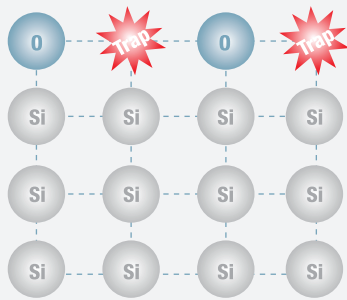
# 신성장동력 - 고압 어닐링 장비

## 반도체 신뢰성 및 집적회로 성능 향상 가능한 고압 어닐링 장비 국산화

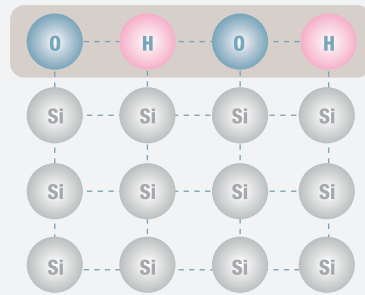
### 고압 어닐링 장비 개요

#### Hydrogen passivation

반도체 Si 표면 결함을  
고압 수소·중수소로 치환



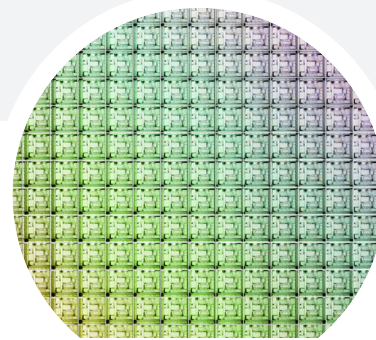
Dangling Bond  
발생



Hydrogen passivation  
공정 후

#### 계면결함 Dangling Bond

반도체 산화공정에서 계면의 산소와  
공유결합을 하지 못한 Si가 발생



반도체 웨이퍼 표면

### 예스티 고압 어닐링 장비 특징

고압 어닐링  
장비 국산화

중수소 리액터 장치  
관련 특허 출원 완료

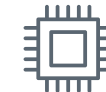
리드타임 축소 & 가격경쟁력 극대화

30기압  
고압 처리 가능

100%  
중수소 농도 유지



신뢰성 향상



회로성능 ↑

계면의 접합부분에 빈자리가 생겨  
터널링으로 인한 누설 전류 발생

# 신성장동력 - 고압 어닐링 장비

## 반도체 신뢰성 및 집적회로 성능 향상 가능한 고압 어닐링 장비 국산화

|      |          | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------|----------|------|------|------|------|------|------|
| 파운드리 | SAMSUNG  | 10nm | 7nm  |      | 3nm  |      | 2nm  |
|      | tsmc     | 7nm  | 5nm  |      | 3nm  |      | 2nm  |
|      | intel    | 7nm  |      |      | 5nm  | 3nm  | 2nm  |
| 메모리  | SAMSUNG  | 1Y   |      | 1Z   | 1A   |      | 1B   |
|      | SK hynix | 1Y   | 1Z   |      | 1A   | 1B   |      |

### 반도체 공정 미세화 장점

반도체 칩 생산량



Wafer 1개당 생산가능 칩 개수 ↑,  
반도체 생산 효율성 증대

성능 · 전력효율



회로 내 저항 감소,  
발열량 감소 및 전력효율 상승

### 고압 어닐링 장비의 필요성



반도체 공정이 미세화되면서 MOSFET 소자에서  
기존과 달리 동작하는 열화 현상을 개선

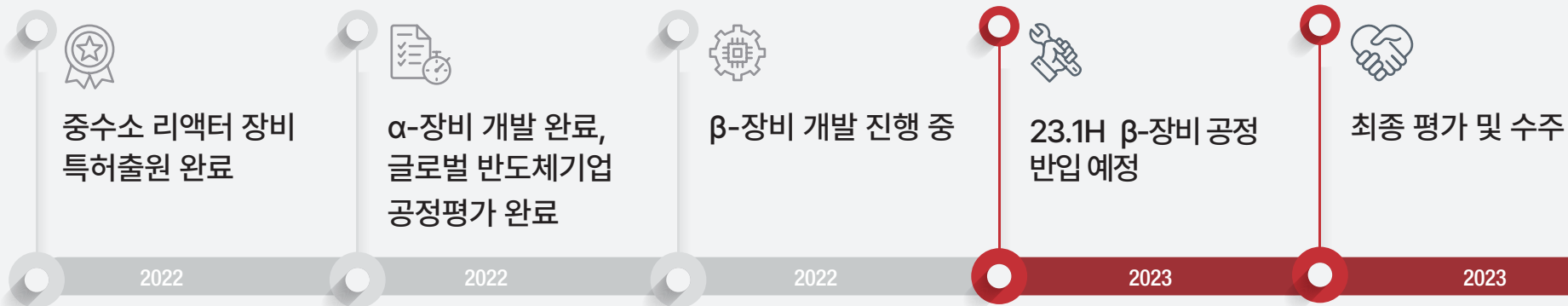


16nm 이하 미세화 공정에서 고온 장비 적용 불가,  
제한 온도 내에서 적용 가능한 고압 어닐링 장비 필요성 ↑

# 고압 어닐링 장비 개발 현황 및 향후 전망

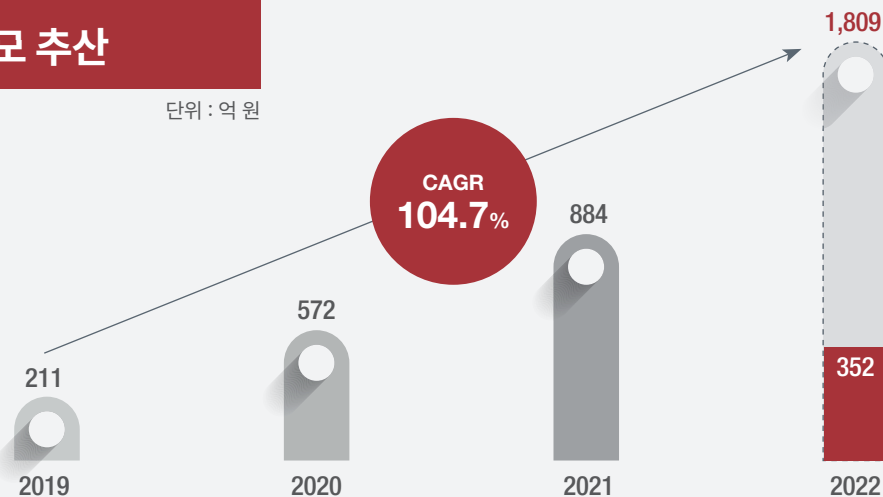
## 2023년 상반기 베타 장비 필드 테스트 진행, 급성장하는 고압 어닐링 장비 시장 진출

### 고압 어닐링 장비 개발 현황·계획



### 고압 어닐링 장비 시장 규모 추산

단위 : 억 원



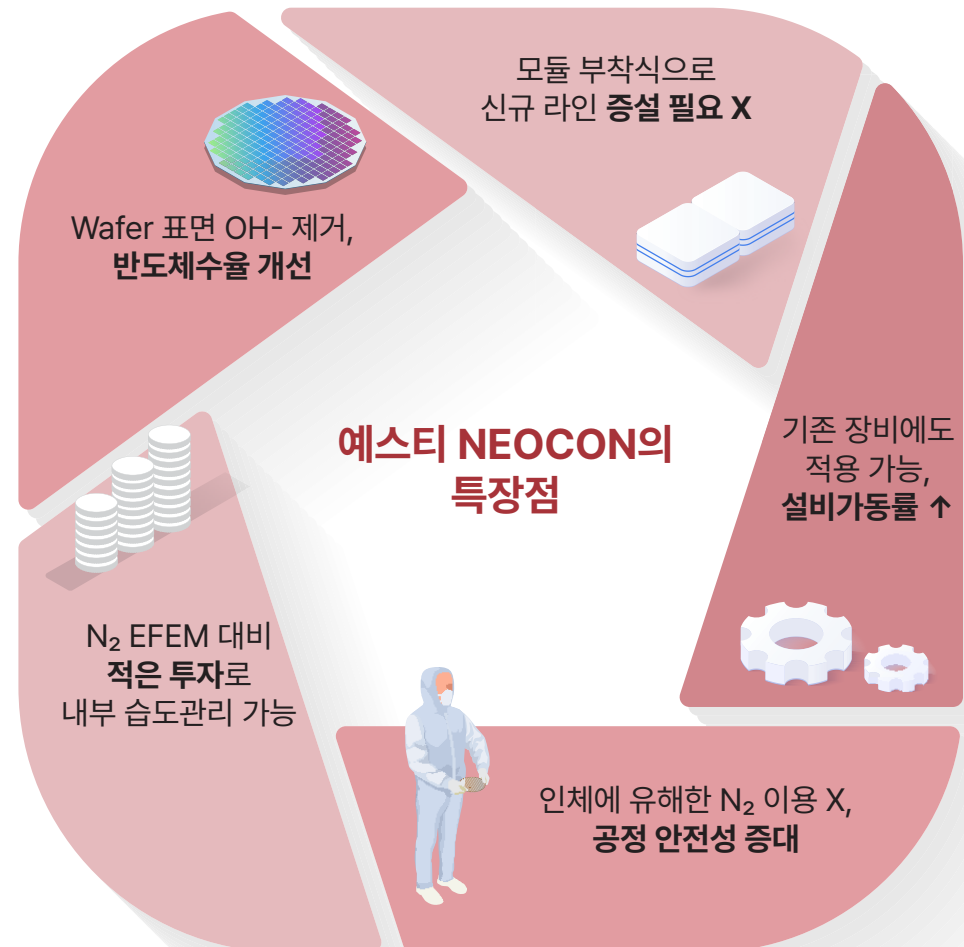
\* 출처: H사 투자설명서 中 고압 어닐링 장비 매출액

# 네오콘(NEOCON) 개요

## N<sub>2</sub> EFEM의 단점 개선된 습도제어장비 NEOCON 양산 개시

### 차세대 습도 제어 장비

|                                                                                                             |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>N<sub>2</sub> EFEM</p> |  <p>에스티 NEOCON</p>  |
| <p><b>개요</b></p> <p>20나노 이하 공정에서 발생하는 Fume으로 인한 신뢰성 저하 현상 개선을 위해 개발</p>                                     | <p>질소 사용 없이<br/>N<sub>2</sub> EFEM 수준의 습도 제어,<br/>기존 장비의 N<sub>2</sub> 관련 비용<br/>전액 절감(연간 3~5천억원)</p> |
| <p><b>기능</b></p> <p>N<sub>2</sub> 가스를 이용해<br/>EFEM 내부 습도 관리</p>                                             | <p>기존 EFEM 공조시스템<br/>유지하면서<br/>제습모듈만 추가,<br/>내부 습도 기준 충족</p>                                          |



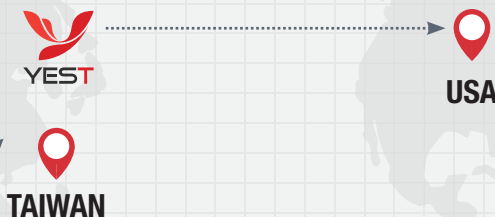
# 네오콘(NEOCON) 현황 및 목표

파운드리 및 메모리 공정에서 평가 진행 中, 글로벌 반도체 기업 및 미국 등 해외 공급

## NEOCON 개발 현황 및 목표



## 2023년 하반기 미국·대만 등 해외 진출 목표



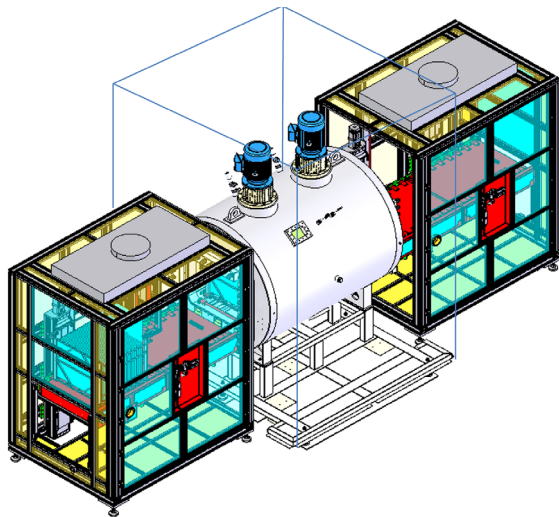
# PCO 장비

## FC-BGA 수요 급증으로 국내외 기판 기업 증설 ↑, 레퍼런스 기반 점유율 확대

**개요** 패키징 공정에서 층간 절연소재가 도포된 기판에 미세 기포 제거·경화하는 장비

**기능** 반도체 기공(VOID) 최소화 및 접착 강도 증대

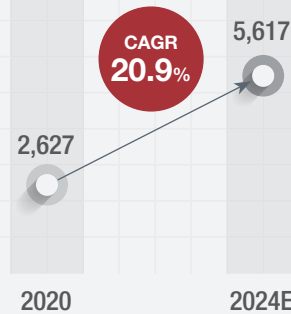
**적용기판** 고성능 패키지 기판(FC-BGA)



▲ 예스티 저진공 PCO 장비 설계도

### 글로벌 FC-BGA 수요 전망

단위 : 1000m<sup>2</sup>



자율주행, AI 등으로 인해 수요 급증

### 국내외 FC-BGA 관련 투자 발표 현황



국내외 기판 기업 FC-BGA 증설·투자 ↑

### 예스티 PCO 장비 납품·제작 레퍼런스

● 납품완료 ● 납품예정

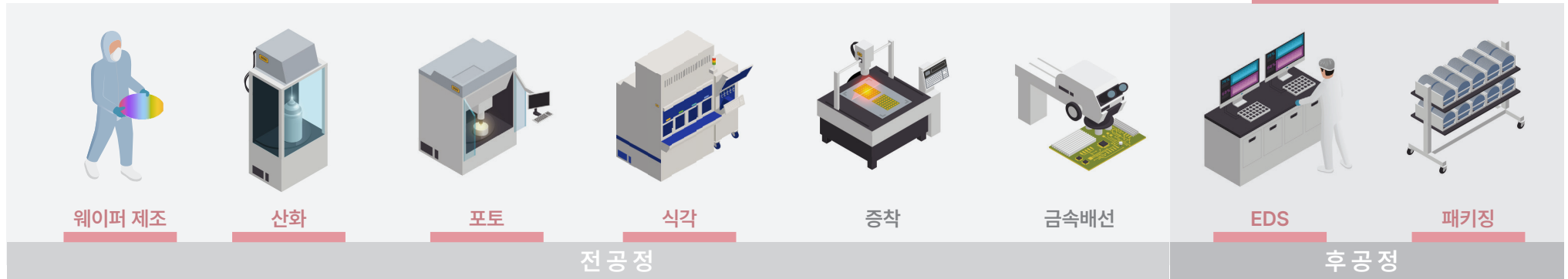


글로벌 종합부품 기업 向

# 주요 반도체 장비

## 반도체 전·후 공정 내 다양한 장비 제조·공급

\* 예스티 반도체 장비 공급 공정



| 퍼니스 · 칠러 장비                |                                             | 가압 큐어 장비                  |                     | 챔버 장비          |                    |
|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| <p>e-Furnace   Chiller</p> |                                             | <p>가압 Cure(AutoClave)</p> |                     | <p>Chamber</p> |                    |
| 적용<br>공정                   | EDS 공정(Wafer 테스트·자동선별)                      | 적용<br>공정                  | 패키징 공정(Die-접착필름 접착) | 적용<br>공정       | 패키징 공정(최종 불량유무 선별) |
| 기능                         | Wafer 이물질 제거 & 이온 안정화<br>Wafer 테스트 – 초저온 제어 | 기능                        | 보이드 제거 및 경화         | 기능             | 부품 내후성·신뢰성 모의 테스트  |

# UTG 디스플레이 장비

## 글로벌 디스플레이 기업 베트남법인향 UTG 관련 장비 공급, 급성장하는 폴더블폰 시장 수혜 기대

### 폴더블폰의 핵심 소재 UTG



Ultra Thin Glass (UTG)

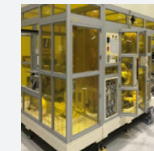
- 100um 미만으로 얇게 가공된 유리에 강화공정을 더해 스마트폰 디스플레이를 보호하는 부품
- 향후 폴더블폰 커버 윈도우 시장 점유율 80% 차지 전망, 주요 디스플레이 업체 UTG 관련 설비 투자 확대 中

\* 출처: 시장조사업체 유비리서치



### UTG 관련 디스플레이 장비

2022.08 | 글로벌 디스플레이 기업 베트남법인  
UTG 관련 장비 공급계약 체결



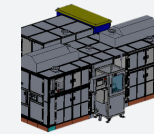
#### Roll 라미네이션

폴더블용 편광필름이나 Touch Panel 합착



#### 진공 라미네이션

폴더블용 강화 글라스 보호필름 합착



#### 강화로 장비

UTG 화학적 강화 완전자동 열처리 시스템



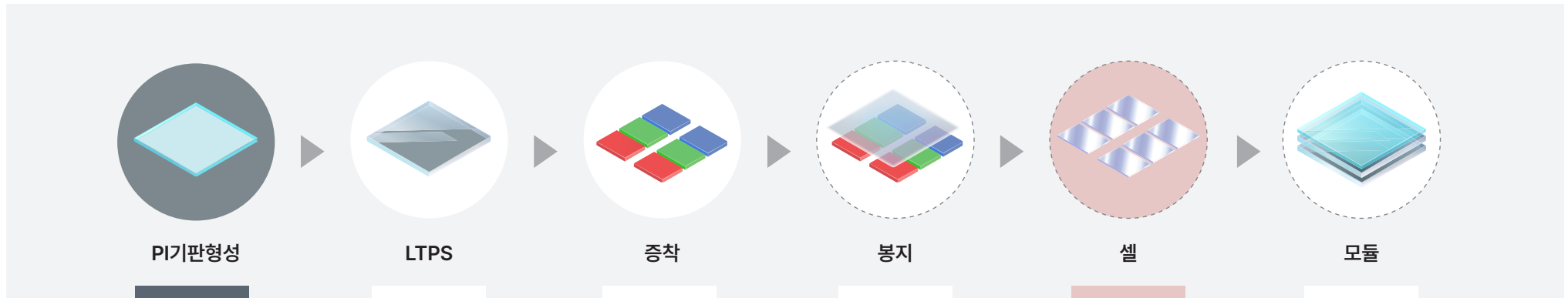
#### 오토클레이브

글라스-필름 접합부 내 잔여기포 제거

# 주요 디스플레이 장비

다양한 디스플레이 공정 장비 라인업 보유 및 일괄화 구축 완료, 이를 통한 수주경쟁력 제고

■ Flexible □ 공통 ■ OLED



디스플레이 공정장비 일괄화

오토클레이브 · 라미네이션 장비 · UV 큐어

| 오토클레이브                                                                                               |                             | 라미네이션 장비                                                                                               |                     | 자외선 경화 장비                                                                                            |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  <p>Autoclave</p> |                             |  <p>Laminator</p> |                     |  <p>UV Cure</p> |                                        |
| 적용 공정                                                                                                | OLED·Flexible 모듈 공정         | 적용 공정                                                                                                  | OLED·Flexible 봉지 공정 | 적용 공정                                                                                                | OLED·Flexible 봉지 공정                    |
| 기능                                                                                                   | 압력을 가해 Filler 및 Film의 기포 제거 | 기능                                                                                                     | Glass에 충격보호 필름 합착   | 기능                                                                                                   | Glass와 Pannel의 접착 과정에서 극자외선 조사, 밀폐제 경화 |

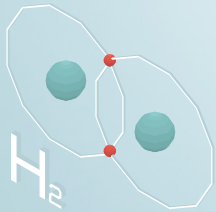
# Chapter. 02

## 신사업 (그린수소)



# 그린수소 Overview

## 수소 생산 기술 내재화 & 상용화로 그린수소 시장 진출



그린수소  
생산기술 개발

### 01. 사업화

Anion  
Exchange  
Membrane

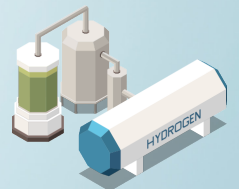
음이온교환막  
(AEM) 기술



### 02. 상용화

수소생산  
선도기업으로 도약

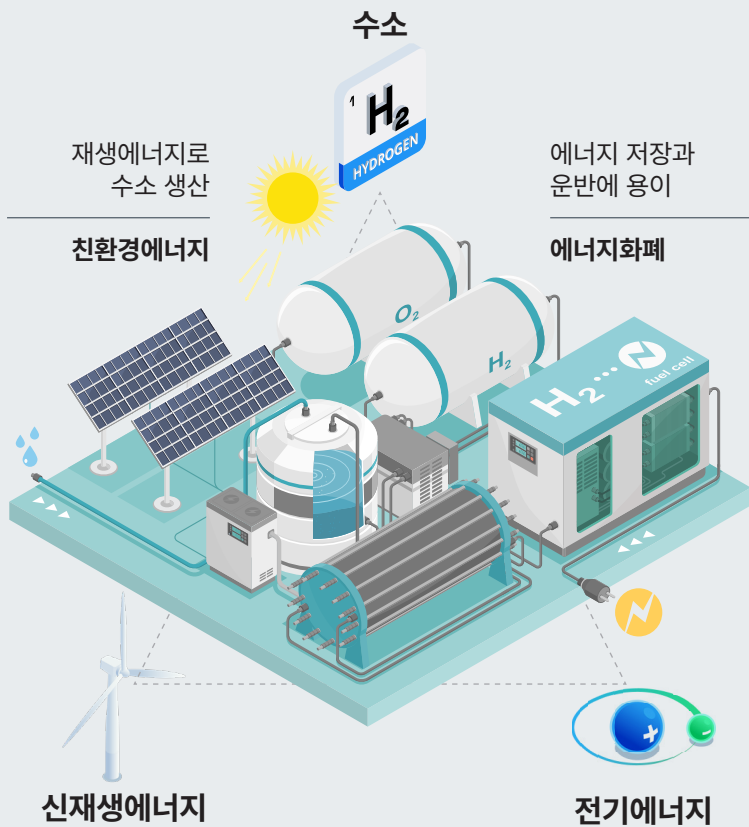
대량생산체계 및  
밸류체인 구축



# 그린수소 사업화 전략 개요

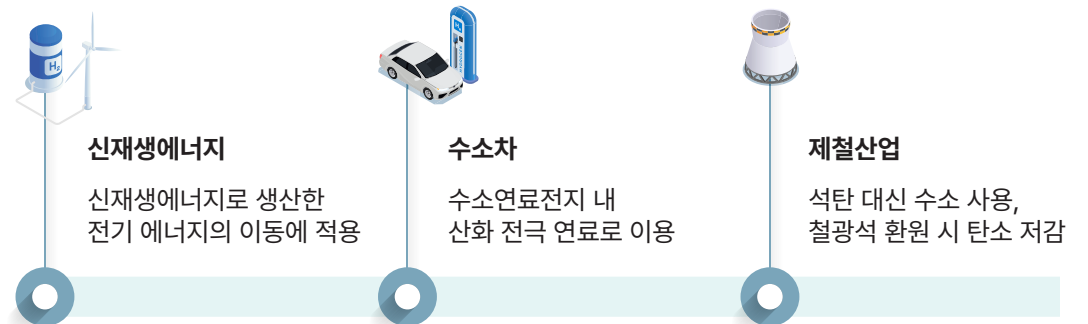
## 다양한 분야에 활용도 높은 수소, 관련 정책으로 시장 확대

### 수소 에너지의 필요성



신재생에너지 기반, 전기에너지 거래에 활용 가능한 수소

### 수소 에너지 활용 분야



### 수소 활성화 정책

|    |                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------|
| 생산 | 단기 - 2027년까지 100MW급 그린수소 생산시설 구축                             |
|    | 장기 - 대규모 그린수소 생산기지 '에너지섬' 조성방안 검토 중                          |
| 유통 | 석탄화력 · LNG 발전 연료로 사용, 석탄·LNG 사용량 ↓<br>한국가스공사 필두로 수소 운반 기술 개발 |
| 활용 | 모빌리티 중심 수소 활용분야 확대                                           |

# 그린수소 사업화 전략

## 음이온교환막 수전해 기술 자체 개발, 플랜트·충전소·에너지자립시스템에 장치 공급

### 그린수소의 정의 및 특징



재생에너지로 만든 전력 이용,  
물을 분해해서 생산

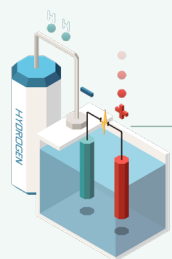
생산과정에서  
CO2 배출 없음



천연가스(메탄), 석탄 등을  
고온 · 고압에서 분해해 생산

수소 1kg 생산 시  
CO2 5~10kg 배출

### 그린수소 생산 수전해기술 비교



Anion Exchange  
Membrane

#### 음이온교환막(AEM)

설비 가격이 낮으면서  
높은 수소 생산성 보유,  
그린수소 생산 최적화 기술

VS

고체산화물(SOEC)

알칼라인(AEC)

전해질막(PEM)

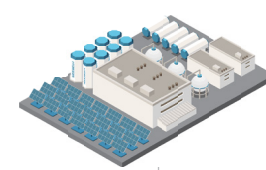
SOEC - 시동시간 길고 고온 필요

AEC - 낮은 수소 생산성

PEM - 고가설비 필요

타 수전해기술의 단점

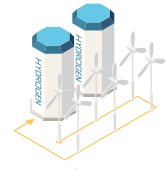
### 에스티 수전해장치 구매 Target



그린수소  
생산 플랜트



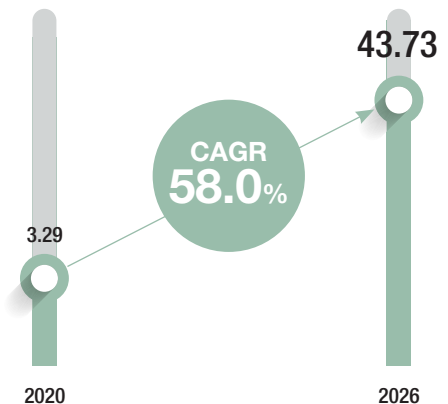
On-Site  
수소 충전소



재생에너지 연계  
에너지 자립시스템

### 글로벌 그린수소 시장 규모 전망

단위 : 억 달러



# 그린수소 상용화 전략 개요

그린수소 대량생산 & 인프라 구축으로 상용화 및 시장 선점,  
에스티 고유기술 접목해 효율 극대화



## HYDROGEN

### 반도체·디스플레이 설비 기술 접목

- 반도체 집적기술 및 중수소 핸들링 경험 접목, 그린수소 시스템 운영 최적화
- 열·압 처리 노하우 기반 재생에너지 활용률 극대화

### 그린수소 대량생산체계 확보

- 그린수소 생산 실증사업 참여, 운영효율 및 내구성 향상
- 수전해 기반 S-HRS 시스템 개발 실증 사업 참여, 일 생산량 10kg급 AEM 수전해시스템 적용

### 상용화 밸류체인 구축

- 獨 인애펀터와 협력, 상용화를 위한 인프라 구축 목표
- 영업망, A/S Network, 상용화 노하우 확보
- 시장상황 파악, 사업모델 구축 진행

# 그린수소 상용화 전략 (1) - 대량생산체계 구축

AEM 수전해기술 실증 진행 中, 향후 그린수소 대량생산체계 구축 및 해외 진출

## 에스티 그린수소 관련 국책사업 참여 현황

제주 12.5MW급  
그린수소 생산 실증사업



실증단지 사이트 내 2MW 설치 예정

AEM을 비롯한 4가지  
수전해 방식 모두 설치

수전해 기반 350bar급  
S-HRS 시스템 개발과 실증사업



태양광 연동 온사이트 수소충전시스템

일 10kg급 AEM 수전해시스템 적용,  
수소전기차 충전에 활용

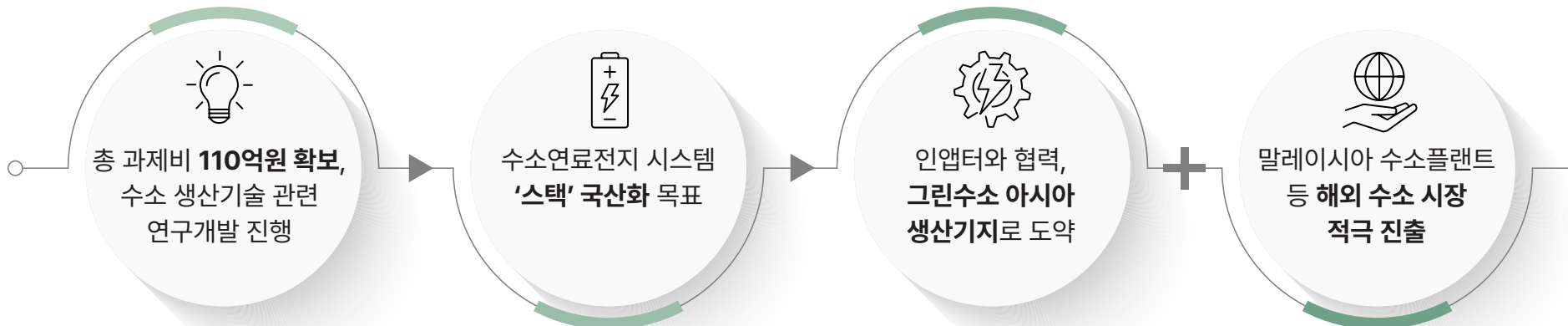
차세대 고성능 고내구성  
AEM 수전해 핵심 기술개발 사업



국책사업 주요 참여기관으로 참여

AEM 구성부품 및 주변장치의  
요소 기술과 모듈화

## 그린수소 사업 향후 계획



# 그린수소 상용화 전략 (2) -에스티 기술 접목

보유 핵심 기술을 접목해 시스템 운영 최적화 실현, 이를 통해 활용 다각화 발판 마련



# 그린수소 상용화 전략 (3) - 인애퍼의 밸류체인 활용

세계 최초 AEM 상용화 성공 기업과 파트너십 체결, 그린수소 생태계 구축 가속화

세계 최초·세계 유일 AEM 방식  
수전해 기술 상용화 성공 기업



전 세계 40여개 국,  
166여개 실증 사이트 수전해장치 공급



환경 분야 노벨상  
기후문제해결 부문 수상

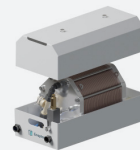


국제 수소 산업 전시회 참가,  
예스티와 수전해장치 EL4.0 공개



23년 상반기 독일 소재  
대규모 생산기지 완공 예정

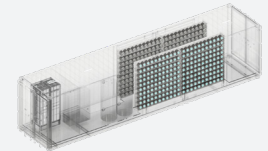
## 모듈구조



스택



모듈



컨테이너

## 특장점



단순한  
운영 시스템



높은  
확장성



재생에너지  
활용률 98%

전 세계 다양한 프로젝트에 적용 중  
인애퍼의 풍부한 인프라 및 밸류체인 활용 가능



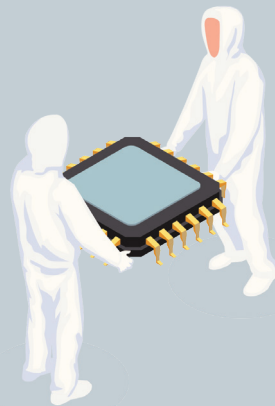
LAVO의 40kWh 급 태양광  
연계 수전해 발전기에 공급



Starfire Energy의 암모니아  
대량 생산 상업용 모듈 납품

# Chapter. 03

## 계열사



# 계열사 – YHT·YDI·YOT

## 계열사 YHT·YDI·YOT를 통해 반도체 & 2차전지 부품 사업 진행 중

계열사



주요 제품



Heater Jacket Controller



Silicone Coated Glass Fiber



Silicone Wheel



EMC Grinding Wheel



Aspherical surface glass lens

개요

반도체 공정 히팅자켓 전문기업

반도체용 다이아몬드 공구 전문기업

2차전지용 비구면 글라스렌즈 전문기업

경쟁력

히팅자켓 관련 국내·국제 특허 보유

반도체 휠 공정 자동화 진행

고품질 제품 & 생산 장비 완전자동화

고객사

국내외 글로벌 반도체 기업

국내 주요 반도체 기업

전기차 배터리 모듈 생산업체

목표

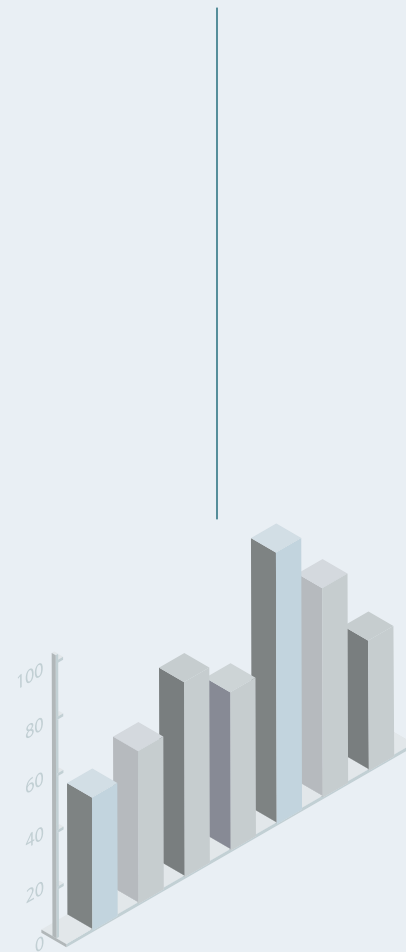
2023년 매출 300억 목표

2025년 매출 100억 목표

2024년 매출 100억 목표

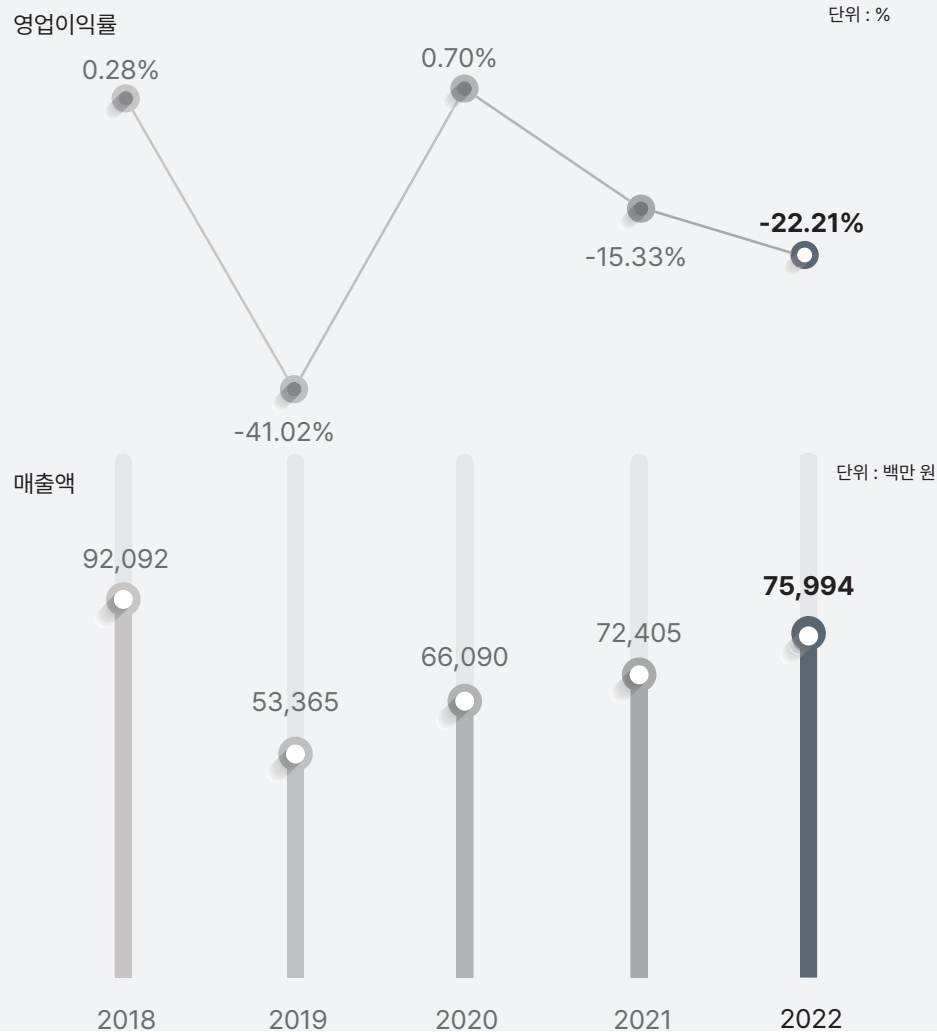
# Chapter. 04

## Performance

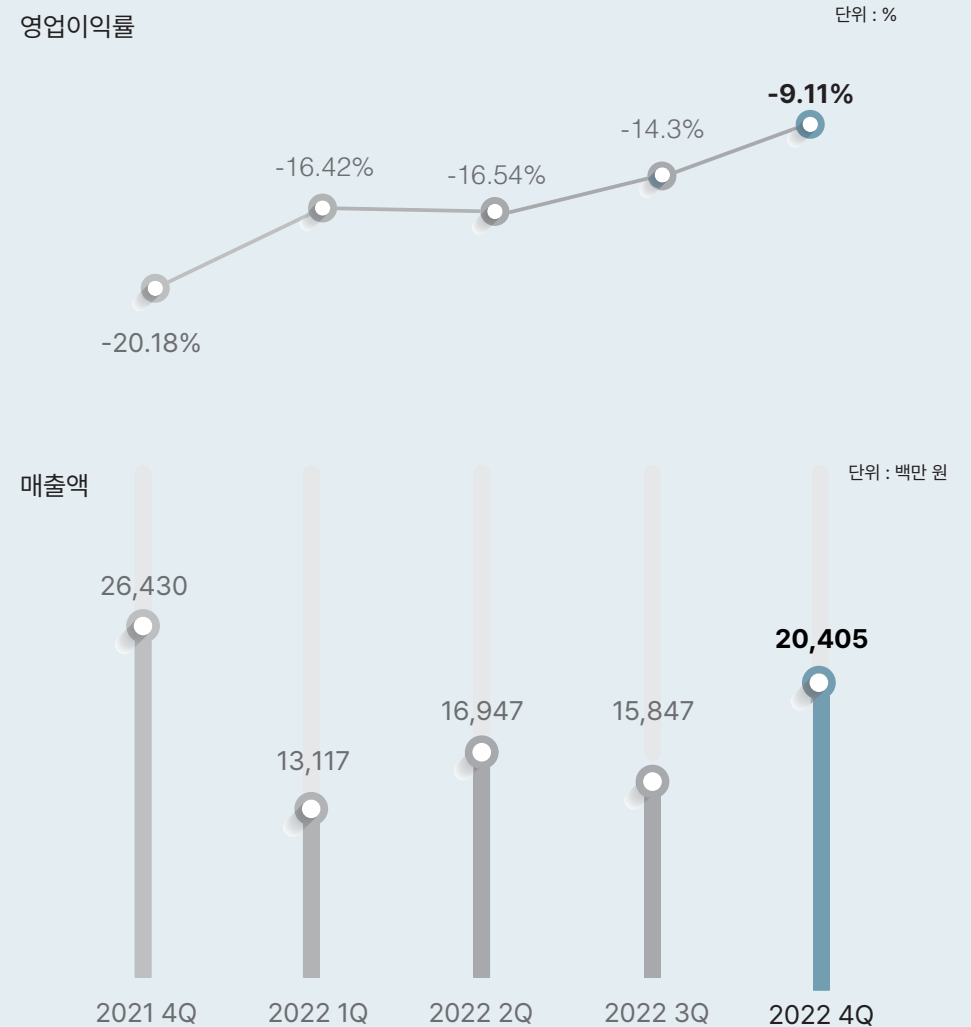


# Performance

## 연도별 실적



## 분기별 실적



# Chapter. 05

## 일반개요



# Company Overview

## 회사 개요

|      |                     |
|------|---------------------|
| 회사명  | 예스티                 |
| 대표이사 | 장동복, 강임수(각자대표)      |
| 설립일  | 2000년 3월 6일         |
| 자본금  | 90.26억원(22.3Q 기준)   |
| 주요사업 | 반도체 및 디스플레이 장비 제조   |
| 임직원수 | 186명(22.3Q 기준)      |
| 소재지  | 경기도 평택시 진위면 삼남로 654 |
| 홈페이지 | www.yest.co.kr      |

## 대표이사 소개

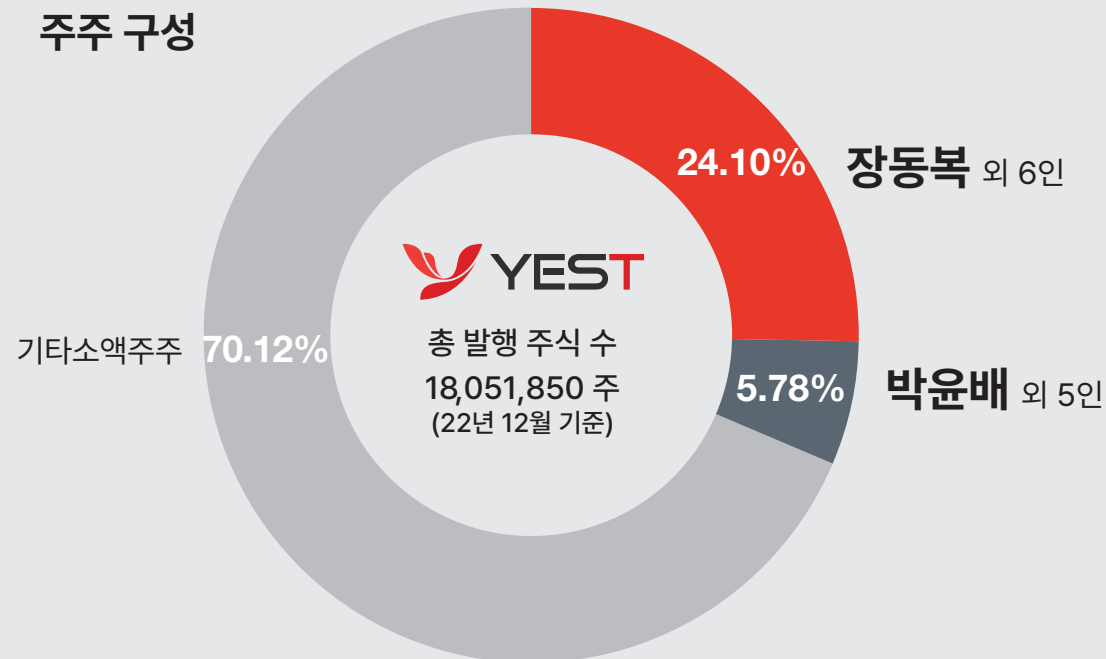
### 장동복 대표이사

- (現) 예스티 대표이사
- 2000.03.06 예스티 설립
- (前) 케이씨텍 기술영업
- (前) 세중반도체 기술영업

### 강 임 수 대표이사

- (現) 예스티 대표이사
- (前) 삼성전자 DDI 설계그룹장
- (前) 삼성전자 전략마케팅팀장
- (前) 삼성전자 LSI 개발실장

## 주주 구성

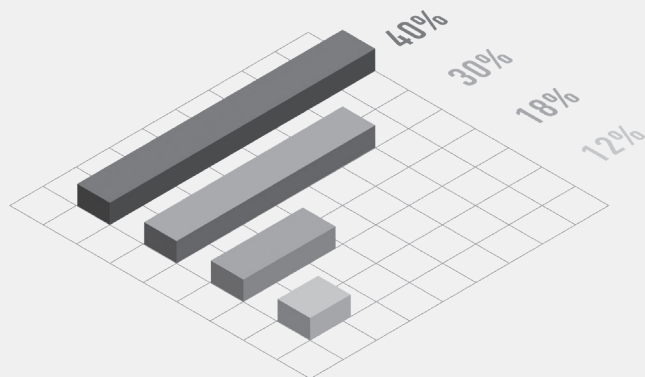


# 주요연혁



# Chapter. 06

## Appendix



# 요약 재무제표

단위 : 백만 원

| 연결 재무상태표 |         |          |         |
|----------|---------|----------|---------|
| 구분       | 2020    | 2021     | 2022    |
| 유동자산     | 39,213  | 68,653   | 44,521  |
| 비유동자산    | 113,525 | 146,331  | 145,219 |
| 자산총계     | 165,738 | 214,984  | 189,740 |
| 유동부채     | 70,269  | 83,442   | 71,587  |
| 비유동부채    | 30,016  | 46,483   | 71,928  |
| 부채총계     | 100,285 | 129,925  | 107,752 |
| 자본금      | 7,472   | 8,646    | 9,026   |
| 자본잉여금    | 55,832  | 89,090   | 65,888  |
| 기타자본조정   | (6,780) | (2,199)  | (6,966) |
| 이익잉여금    | 6,162   | (13,196) | 13,894  |
| 자본총계     | 65,453  | 85,059   | 81,989  |

단위 : 백만 원

| 연결 손익계산서           |        |          |          |
|--------------------|--------|----------|----------|
| 구분                 | 2020   | 2021     | 2022     |
| 매출액                | 66,090 | 72,405   | 75,994   |
| 매출원가               | 54,281 | 65,548   | 70,842   |
| 매출총이익              | 11,809 | 6,858    | 5,152    |
| 판매비와 관리비           | 11,345 | 17,960   | 22,034   |
| 영업이익               | 464    | (11,102) | (16,882) |
| 금융수익               | 7,475  | 3,845    | 9,822    |
| 금융원가               | 3,131  | 21,407   | 4,595    |
| 법인세비용차감전<br>계속사업이익 | 2,366  | (20,680) | (7,316)  |
| 순이익                | 405    | (21,632) | (5,230)  |

# 요약 재무제표

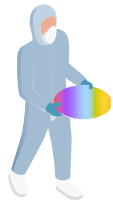
단위 : 백만 원

| 별도 재무상태표 |         |          |         |
|----------|---------|----------|---------|
| 구분       | 2020    | 2021     | 2022    |
| 유동자산     | 37,055  | 65,153   | 43,670  |
| 비유동자산    | 104,079 | 119,513  | 120,533 |
| 자산총계     | 154,134 | 184,667  | 164,203 |
| 유동부채     | 62,182  | 68,083   | 54,988  |
| 비유동부채    | 28,686  | 35,610   | 26,501  |
| 부채총계     | 90,868  | 103,692  | 81,489  |
| 자본금      | 7,472   | 8,646    | 9,026   |
| 자본잉여금    | 55,832  | 89,950   | 66,749  |
| 기타자본조정   | (6,797) | (2,216)  | (5,783) |
| 이익잉여금    | 5,350   | (15,955) | 13,023  |
| 자본총계     | 63,266  | 80,974   | 82,714  |

단위 : 백만 원

| 별도 손익계산서           |        |          |         |
|--------------------|--------|----------|---------|
| 구분                 | 2020   | 2021     | 2022    |
| 매출액                | 63,475 | 69,337   | 66,317  |
| 매출원가               | 53,147 | 62,644   | 59,662  |
| 매출총이익              | 10,328 | 6,693    | 6,655   |
| 판매비와 관리비           | 9,584  | 14,680   | 611     |
| 영업이익               | 744    | 7,987    | (9,081) |
| 금융수익               | 7,481  | 4,038    | 9,196   |
| 금융원가               | 2,917  | 20,944   | 3,529   |
| 법인세비용차감전<br>계속사업이익 | 3,515  | (23,130) | (1,706) |
| 순이익                | 1,612  | (23,606) | (850)   |

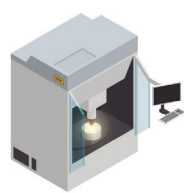
# #. 반도체 장비



웨이퍼 제조



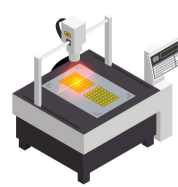
산화



포토



식각



증착



금속배선

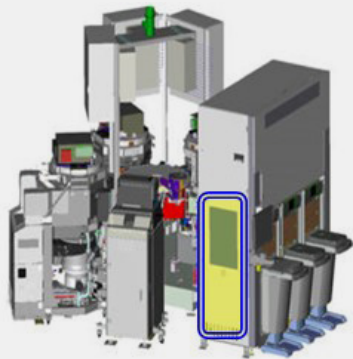


EDS



패키징

## Smart Storage



Smart Storage

적용공정

식각 공정  
(반도체 회로 패턴 형성)

기능

ETCH 공정 완료된 웨이퍼와  
대기 중인 웨이퍼 분리, 흙 제거

## PRIMUS-IR



PRIMUS-IR

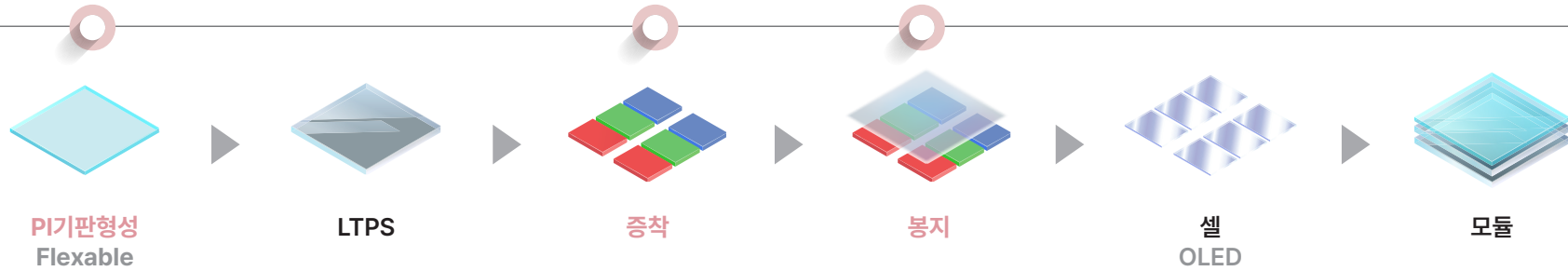
적용공정

패키징 공정  
(PLP:웨이퍼를 사각형으로 절단)

기능

패널 기판의 경화 및  
열처리 공정 수행

# #. 디스플레이 장비



## FPD Furnace



Flat Panel Display Furnace

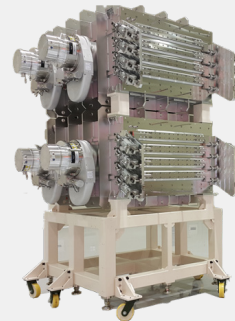
적용  
공정

PI 기판형성 공정  
(기판에 PI Varnish 도포)

기능

PI 도포 후 고온 열처리로  
유기막 경화 및 소자 특성 개선

## VDO



Vacuum Dry Oven

적용  
공정

증착 공정  
(유기물층을 기판 표면에 부착)

기능

고방사율 적외선 히터 이용,  
패널의 유기막 내 수분을 진공 건조

## Photo VCD



Photo VCD(Vacuum Chamber Dry)

적용  
공정

봉지 공정  
(패널과 공기·수분 차단)

기능

Photo Resit Coating 후 유기용제 제거

